

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-017

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于全资子公司投资建设上海澜博半导体设备 制造中心建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**上海澜博半导体设备制造中心建设项目（以下简称“新建半导体设备制造中心”、“本项目”）；

● **投资金额：**不超过4亿元；

● **已履行的审议程序：**本次投资已经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过，本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

1、**投资项目审批风险：**本次投资项目需获得政府相关部门关于土地使用权、环境影响评估等事项的审批或备案。若公司未能按预期完成上述审批或备案，可能导致项目建设进度不及预期，进而对项目投资效益产生不利影响；

2、**投资项目实施进度可能不及预期的风险：**公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计，但项目进度安排是基于过往项目经验推测确定的。若项目建设过程中出现意外情况，可能导致工期延长，因此存在项目实施进度不及预期的风险；

3、**投资项目无法达到预期收益的风险：**本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。由于项目实施周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性；

4、**项目资金筹措风险：**本项目计划总投资额为不超过人民币4亿元，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。若公司未来经营

性现金流状况不及预期，或融资环境发生不利变化，项目资金的按时、足额投入存在一定不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的发展战略及业务布局，公司拟在上海市青浦区华新镇投资建设“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”。项目总投资不超过4亿元，建设集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	上海澜博半导体设备制造中心建设项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：不超过4亿元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月10日召开第二届董事会战略委员会第四次会议、于2026

年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目的议案》。同时，董事会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜，包括但不限于协议签署、项目立项备案、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购与招标、工程建设管理等本项目实施之必要事项。

本项目在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

基于公司发展战略及业务布局，公司拟投资不超过4亿元，购买土地约30亩，建设不超过5.5万平方米的集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心，其中包含生产车间、综合办公楼及配套建筑，并购买先进的生产、研发设备，最终建立公司半导体设备生产运营中心，提高公司产品测试分选机制造及公司运营能力的同时进一步增强公司在长三角区域的综合服务能力。

（二）投资标的的信息

1. 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	上海澜博半导体设备制造中心建设项目
项目主要内容	半导体设备生产运营中心
建设地点	上海市青浦区华新镇（以相关政府主管部门审批通过后的地址为准）
项目总投资金额（万元）	40,000
上市公司投资金额（万元）	40,000
项目建设期（月）	36
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2. 各主要投资方出资情况

公司全资子公司上海澜博半导体设备有限公司为本项目的建设主体，拟出资不超过 4 亿元建设本项目。

3. 项目目前进展情况

本项目目前尚处于前期筹备阶段，需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记工作。

4. 项目建设的必要性及可行性分析

(1) 项目建设的必要性

1) 扩充现有产能，更好地响应市场需求增长

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025 年全球半导体行业延续增长态势，给半导体设备带来广阔的市场空间。公司现有产能已难以满足客户未来中长期的需求，需要通过新增产能以更好地满足市场及客户需求。

2) 产品结构升级，需针对性扩充配套产能

随着芯片测试的复杂度攀升，这对半导体测试分选设备在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面提出了更高的要求。针对于对温度控制、热管理效率及动态适配能力等要求高的复杂测试的测试分选机产品，其在生产制造过程中对在结构承重、电力容量等方面较传统测试分选机提出了更高的要求。

公司现有租赁厂房在结构承重、电力容量等方面难以支撑公司未来测试分选机的研发生产需求。新建半导体设备制造中心将在厂房用电、环境控制、空间布局等方面进一步升级，为公司长期发展奠定基础。

3) 拓展研发、制造等运营空间，优化运营效率

相较于当前租用的位于上海市青浦区嘉松中路 2188 号的厂房(以下简称“现有租赁厂房”)，新建半导体设备制造中心可以提供更专业的研发实验室、产品测试区、生产制造车间及综合办公空间。可进一步优化生产工艺流程、提升设备交付效率与品质稳定性，进一步夯实公司在半导体设备领域的规模化制造能力与核心竞争优势。

公司现有租赁厂房物流区通道宽度有限，在一定程度上影响原材料到货及设备出货等效率，新建半导体设备制造中心将全面优化物流配套设施，为公司中长期发展提供基础保障。

4) 完善人才配套，进一步增强团队稳定性与创新力

新建半导体设备制造中心拟建设配套宿舍、食堂等生活设施，有利于进一步降低人才流失率，吸引高端研发人才，为公司在技术攻关、产品研发及制造等领域持续注入创新活力，进一步增强团队稳定性与创新力。

（2）项目建设的可行性

1) 半导体设备市场发展前景广阔

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。根据国际半导体产业协会（SEMI）预测，2025 年全球半导体设备市场规模预计同比增长 13.7%，市场前景广阔。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。本项目符合国家产业政策和战略导向。同时，上海半导体产业聚集效应突出，为本项目落地与发展营造了优质发展环境。

2) 公司深耕测试分选机领域，为项目实施奠定基础

公司自成立以来一直深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元到 21,000 万元，同比增加 103.87%到 167.58%。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资对公司业务的影响

本次投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目是公司基于自身的发展战略和业务布局做出的审慎决定，本项目拟建设不超过 5.5 万平方米的集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心，其中包含生产车间、综合办公楼及配套建筑，并购买先进的生产、研发设备，最终建立公司半导体设备生产运营中心。在提高公司产品测试分选机制造及公司运营能力的同时将进一步增强公司的综合服务能力及核心竞争能力。

（二）本次投资对公司财务状况的影响

新建半导体设备制造中心项目目前尚处于筹划阶段，考虑到本项目投资金额大，建设周期较长，预计短期内不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。从长远发展的战略方向看，项目若顺利建成并达产，预计对公司未来财务状况和业务发展产生积极影响。

本项目建设期三年，总投资 4 亿元，按项目建设进度、工程节点及验收情况分阶段、分批次支付，具体计划如下：项目建设期第一年（2026 年）预计支付本项目 60% 的投资款；项目建设期第二年（2027 年）预计支付本项目 32% 的投资款；项目建设期第三年（2028 年）预计支付本项目 8% 的投资款。本次投资建设项目建设资金来源为公司自有或自筹资金，公司已对本项目所需资金进行统筹规划，截至 2026 年 1 月 31 日，公司账面可用资金（含自有资金短期理财；扣除 IPO 募集资金等专项资金）约 4 亿元。公司现有流动资金贷款未使用额度约 5 亿元。本项目对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。公司已制定资金使用规划，并将持续强化现金流管理，加快主营业务资金回笼为项目推进提供稳定支持。同时，公司将根据工程进度动态按需安排融资计划，积极与金融机构保持沟通确保项目建设资金及时到位。

四、对外投资的风险提示

1、投资项目审批风险：本次投资项目需获得政府相关部门关于土地使用权、环境影响评估等事项的审批或备案。若公司未能按预期完成上述审批或备案，可能导致项目建设进度不及预期，进而对项目投资效益产生不利影响；

2、投资项目实施进度可能不及预期的风险：公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计，但项目进度安排是基于过往项目经验推测确定的。若项目建设过程中出现意外情况，可能导致工期延长，因此存在项目实施进度不及预期的风险；

3、投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

由于项目实施周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性；

4、项目资金筹措风险：本项目计划总投资额为不超过人民币4亿元，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。若公司未来经营性现金流状况不及预期，或融资环境发生不利变化，项目资金的按时、足额投入存在一定不确定性。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年2月12日